

2023年3月期

決算補足資料

2023年5月10日



注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、新型コロナウイルス等の感染症を含め、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

2023年3月期 連結実績

(単位：億円)

	2022年3月期 通期実績	2023年3月期 通期実績	増減率	2024年3月期 通期予想	増減率
売上高	1,513	1,673	10.6%	1,650	-1.4%
営業利益	133 8.8%	96 5.7%	-27.8%	90 5.5%	-6.0%
経常利益	143 9.5%	112 6.7%	-21.6%	80 4.8%	-28.7%
当期純利益	115 7.6%	88 5.3%	-22.7%	62 3.8%	-29.9%
期中平均為替レート (JPY/USD)	113.06	136		130	

2023年3月期 商品別実績

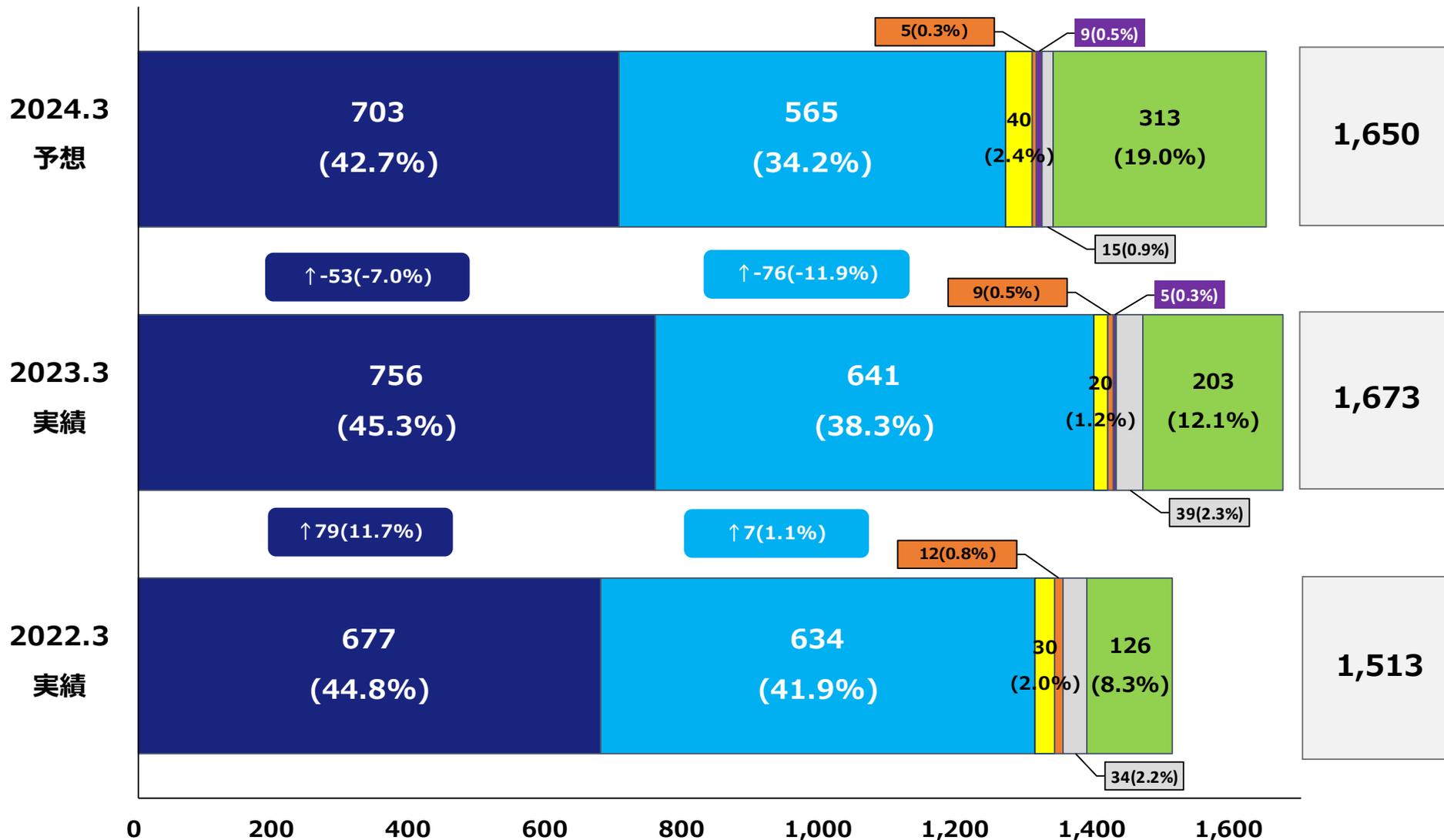
(単位：億円)

	2022年3月期		2023年3月期		2024年3月期	
	実績		実績		予想	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
		営業利益率		営業利益率		営業利益率
車載	732	63	845	60	815	46
		8.6%		7.1%		5.6%
スマートフォン タブレット	332	39	271	11	211	14
		11.7%		4.1%		6.6%
半導体パッケージ			5		9	-7
		-		0.0%		-77.8%
SSD IoTモジュール	68	11	100	10	89	13
		16.2%		10.0%		14.6%
AI家電 アミューズメント 産機他商品	255	17	249	16	213	14
		6.7%		6.4%		6.6%
EMS 電子機器開発製造	126	3	203	-1	313	10
		2.4%		-0.5%		3.2%
合計	1,513	133	1,673	96	1,650	90
		8.8%		5.7%		5.5%

仕様別売上高シェア

(単位：億円)

■ 貫通板 ■ ビルドアップ ■ リジットフレキ/フレキ ■ 放熱基板 ■ パッケージ ■ その他 ■ EMS

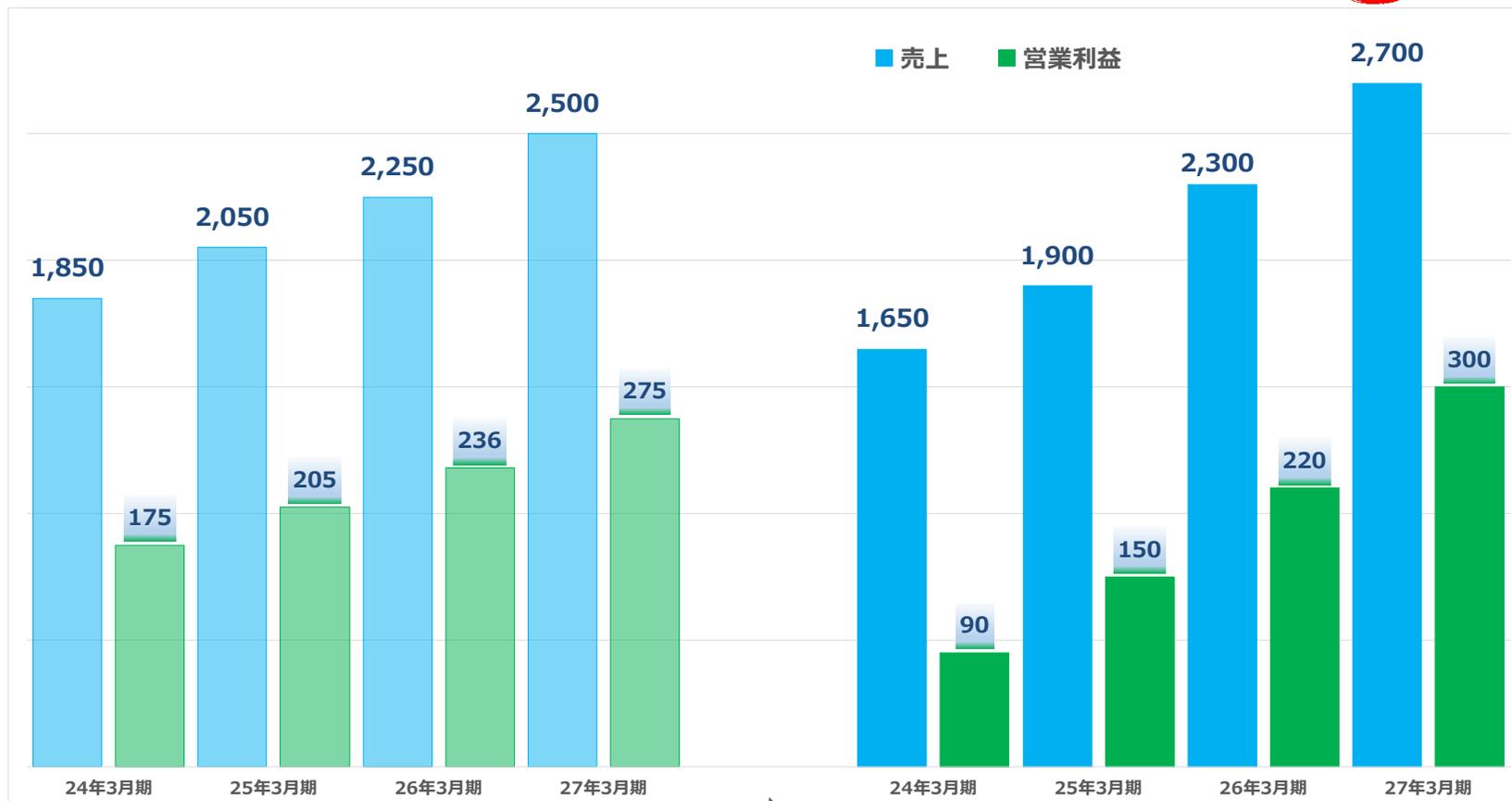


中期経営計画の見直し

(単位：億円)

2022年5月公表計画
24.3-27.3 売上年平均成長率 10.6%

修正計画
24.3-27.3 売上年平均成長率 **17.8%**



EBITDA	24年3月期	25年3月期	26年3月期	27年3月期
	277	320	363	413



EBITDA	24年3月期	25年3月期	26年3月期	27年3月期
	184	269	348	437

2023.3-2027.3 投資合計 1,000億円

2023.3-2027.3 投資合計 900億円